

仕 様 書

1. 件名

AI チップ設計拠点の設計検証システム機器の保守

2. 保守の概要

産業技術総合研究所デバイス技術研究部門（以下産総研）では、AI チップ等の設計開発に必要不可欠な半導体チップ設計検証システムを導入し、これを広く活用できる環境を構築した AI チップ設計拠点（以下、本拠点）を共用施設として運営している（産総研・東大 AI チップデザイン OIL が運用を実施）。本件作業は、2018 年度に導入した「ロジック集積回路設計検証システム」（以下、本システム）のうち、エミュレータと EDA ソフトウェアを除く、情報機器全体について、これまでと同様の保守を継続することを目的とする*。

* 「ロジック集積回路設計検証システム」：資産番号 18AB0931

3. 保守対象物

下記のハードウェアを対象とする。

品目	型番	数量
(1) com01	Dell PowerEdge R940 (67FXCT2)	1
(2) emu01	Dell PowerEdge R940 (67GQCT2)	1
(3) esx01	Dell PowerEdge R640 (67FWCT2)	1
(4) スイッチ sw01	S4048T (6TVRNK2)	1

4. 保守内容

(1) 保守契約の期間等

保守対象(1)～(4)の保守期間は保守開始から1年間とすること。

(2) 保守の周期

定期的な保守はない。ソフトウェアのアップデートがあった際、装置のトラブルなどが起きた際に適宜対応すること。

(3) 保守項目及び内容

保守項目とその内容は以下のとおり。

品目	保守項目
(1) com01	<ul style="list-style-type: none"> ・ ProSupport 4 時間オンサイト保守サービス Reinstare ・ HDD 返却不要サービスエンタープライズ向け ・ 当日対応オンサイト診断サービス ・ 保守期間：2024 年 7 月 30 日～2025 年 7 月 29 日
(2) emu01	<ul style="list-style-type: none"> ・ ProSupport 4 時間オンサイト保守サービス Reinstare ・ HDD 返却不要サービスエンタープライズ向け ・ 当日対応オンサイト診断サービス ・ 保守期間：2024 年 7 月 30 日～2025 年 7 月 29 日
(3) esx01	<ul style="list-style-type: none"> ・ ProSupport 4 時間オンサイト保守サービス Reinstare ・ HDD 返却不要サービスエンタープライズ向け ・ 当日対応オンサイト診断サービス ・ 保守期間：2024 年 7 月 17 日～2025 年 7 月 16 日
(4) スイッチ sw01	<ul style="list-style-type: none"> ・ ProSupport 4 時間対応オンサイト保守サービス(7x24) ・ 当日対応オンサイト診断サービス (システム保証 SLA 適用) ・ 保守期間：2024 年 7 月 30 日～2025 年 7 月 29 日

5. 故障時の対応

保守対象物に故障もしくは不具合が発生した場合、調達請求者からの連絡により、速やかに応急処置等の助言・指示を行うこと。また、電話対応での解決が困難な場合は、専門技術者等を現場に派遣し修理等作業を実施すること。

その際、部品交換が必要でそれが保守の範囲内である場合は速やかに対処すること。範囲外の場合は、調達請求者に連絡するとともに、調達担当者に申し出て協議を行うこと。

下記の場合を除き、必要な部品などは無償で準備し修理すること。

- (1) サポート対象製品の材質や製造上の欠陥または通常の使用方法に起因しない損傷
- (2) サポート対象製品の外観上の損傷または欠陥(擦過痕やへこみなど)
- (3) 受注した請負者以外が修理作業などを行ったサポート対象製品
- (4) サポート対象製品の設置が不正または不適切の場合
- (5) 外部に起因する火災、故意の行為、誤使用、乱用、サポート対象製品に付属の説明書に対する不順守、または不適切な環境での使用によって損傷したサポート対象製品

6. 納入物品

作業報告書：修理作業が発生した際は、作業日や作業内容を記録した作業報告書を作成し、作業完了後に調達請求者に提出すること。
なお、交換部品については、保証期間を明記すること。

(部数：紙媒体 1 部)

完了報告書：保守期間終了時に、契約期間中の保守作業を取りまとめて報告すること。

(部数：紙媒体 1 部)

7. 納入の完了

作業完了の後、「6. 納入物品」に記載された納入物品が過不足なく納入されたことを確認して、納入の完了とする。

8. 納入期限及び実施場所

納入期限：(1) com01： 2024 年 7 月 30 日

(2) emu01： 2024 年 7 月 30 日

(3) esx01： 2024 年 7 月 17 日

(4) sw01： 2024 年 7 月 30 日

実施場所：東京都文京区弥生2-11-16 東京大学武田先端知ビル 203 号室
産業技術総合研究所つくばセンター東京大学浅野連携研究サイト

9. 付帯事項

- (1) 本仕様書の技術的内容及び知り得た情報については、守秘義務を負うものとする。

- (2) 本仕様書の技術的内容に関する質問等については、調達請求者と協議すること。また、本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、調達担当者と協議のうえ決定する。
 - (3) 請負者の責において及ぼした損害は、請負者が賠償すること。
 - (4) サプライチェーン・リスクに対応するため、「IT 調達に係る国等の物品等又は役務の調達方針及び調達手続きに関する申合せ」（平成 30 年 12 月 10 日関係省庁申合せ）に基づき対応を求めることがあるので応じる
- こと。